

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2026-015

华海清科股份有限公司

关于第 1000 台 CMP 装备出机的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●近日，华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第 1,000 台 CMP 装备正式出机并发往国内集成电路龙头企业，充分彰显公司产品与技术实力获得行业高度认可，进一步巩固了公司在国产 CMP 装备领域的龙头地位，持续体现国产高端半导体装备自主可控能力稳步提升。

●公司 CMP 装备在出厂前均已完成相关检测，但机台抵达客户现场后，仍需开展安装调试与工艺验证工作。该过程可能受客户产线适配、技术参数优化等因素影响，存在验证周期延长或验证结果不及预期的风险，公司将全力配合客户推进验收工作。同时，公司新产品机台仍需持续开展市场推广与多客户验证，未来亦存在市场拓展及客户开拓不及预期的风险。

一、本次出机情况及对公司影响

近日，公司第 1,000 台 CMP 装备正式出机并发往国内集成电路龙头企业，充分彰显公司产品与技术实力获得行业高度认可，进一步巩固了公司在国产 CMP 装备领域的龙头地位，持续体现国产高端半导体装备自主可控能力稳步提升。目前，公司 CMP 装备主力机型及新一代产品可全面适配集成电路、功率半导体、三维集成与先进封装、化合物半导体、新型显示、衬底材料等主流应用场景，已批量进入国内先进制程大生产线，部分核心技术指标超越国际先进水平。

当前，人工智能、高性能计算等领域快速发展，有力带动先进制程、先进封

装及芯片堆叠等需求持续提升。CMP 作为实现纳米级表面平整度控制的核心工艺，在先进逻辑、先进存储及先进封装等领域的应用场景与工艺需求不断拓展。公司依托在 CMP 领域积累的深厚技术与产业经验开展前瞻性布局，已形成覆盖关键工艺环节的成套解决方案，在产业升级与市场需求扩张的双重驱动下迎来新的发展机遇。

同时，公司依托在 CMP 装备领域积累的核心技术与产业化经验，持续将技术能力向更多关键工艺环节延伸拓展。目前公司已成功布局减薄装备、离子注入装备、划切装备、边缘抛光装备、湿法装备等高端半导体装备，不断完善关键工艺装备矩阵；并同步推进晶圆再生、关键耗材及维保服务等配套业务，构建起“装备+服务”的平台化发展格局，各业务板块间整体协同效应逐步凸显，为公司持续高质量发展提供了强劲动力。

未来，公司将依托多元化产品矩阵与一体化服务能力，为客户提供更高效、更全面的系统解决方案，一方面聚焦先进制程突破，围绕现有产品体系推进技术迭代，持续提升产品核心性能；另一方面紧跟 HBM、CoWoS 等先进封装技术发展趋势，加快产品革新与品类拓展，抢抓集成电路产业升级与国产替代机遇，进一步增强核心竞争力、提升市场份额。

二、相关风险提示

公司 CMP 装备在出厂前均已完成相关检测，但机台抵达客户现场后，仍需开展安装调试与工艺验证工作。该过程可能受客户产线适配、技术参数优化等因素影响，存在验证周期延长或验证结果不及预期的风险，公司将全力配合客户推进验收工作。同时，公司新产品机台仍需持续开展市场推广与多客户验证，未来亦存在市场拓展及客户开拓不及预期的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 9 日